

製品紹介

3次元計測装置 3DSL-Vega

Wireless All-In-One Handy Scanner



- PC接続不要
- 直射日光下でも計測可能
- 単体で3Dデータ生成
 - ✓ フルカラー3Dデータ
- 解像度変更可能
 - ✓ 0.1mm ~ 10mm
- WiFi/USB-CでPCと通信可能
 - ✓ PCへデータ転送
 - ✓ PCで損傷解析実行
- タッチパネルカラー画面
 - ✓ 2K AMOLED, 6.4"
- 512GB SSD、バッテリー内蔵
 - ✓ 最長1時間連続動作可能
 - ✓ 外部バッテリー接続でさらに長時間稼働可能

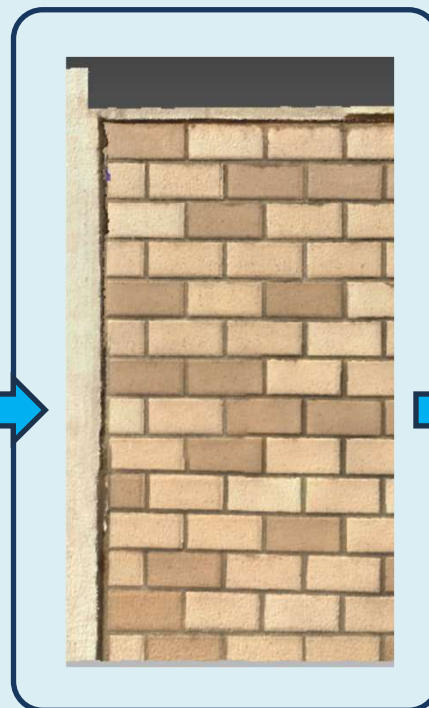
現場点検ですぐに活用できます

使用イメージ

スキャナーのディスプレイを見ながら、所望の範囲を計測します。ゆっくり移動させることがコツです。

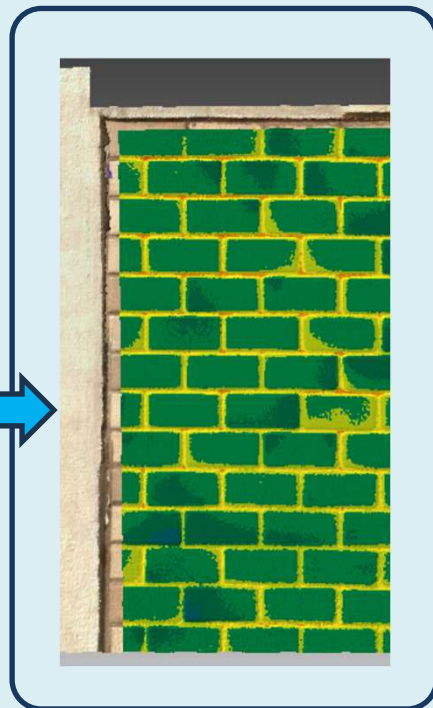


3D



フルカラー3Dデータ

3D ?



凹凸解析結果イメージ

※注意：本文書の内容は今後改訂される可能性があります。

株式会社セイコーウェーブ

<https://www.seikowave.jp>

V1.9

製品紹介

3次元計測装置 3DSL-Vega

特徴と主な仕様

【特徴】

- 赤外線ランダムパターン投影法を採用（レーザー、クラス1）
- 計測所要時間例：50cm x 50cm, 1mm ピッチ => 3分でフルカラー 3Dデータ生成完了
- 対象物のサイズや必要な分解能により、HDモード、Fastモードをユーザが選択
- PC用アプリ StarVision ソフトウェア標準添付（メッシュ化、PLYファイル化など高速に実行可能）
- 解析・評価用ソフトウェアのラインアップ
 - ・POLYGONALmeister®（凹凸解析用）（1台目は標準添付、2台目以降本体のみの販売可能）
 - ・uni-Fitness®（WES2820、API-579 / ASME FFS-1）対応の供用適性評価用ソフト（別売）
- 活用分野：橋梁・圧力容器、鋼構造物・コンクリート構造物等の表面損傷計測、経年変化の記録 等

【仕様】	HDモード	Fast モード
推奨対象物サイズ	300mm x 300mm 以下	1,000mm x 1,000mm 以下
点群間隔設定（可変）	0.1mm ~ 3mm	0.5mm ~ 10mm
対物距離（範囲）	100mm ~ 300mm	270mm ~ 1,000mm
合成モード選択	・特徴点抽出、・テクスチャ抽出 ・マーカーシール利用、・ハイブリッド（組み合わせ）	
合成速度（フレームレート）	最大 15fps	最大 20fps
光源	赤外線MEMS, Laser class 1	赤外線VCSEL, Laser class 1
カメラ画素数	200万ピクセル	130万ピクセル
カラー取得カメラ画素数	4800万ピクセル	
内蔵ストレージ容量	512GB SSD	
スーパーインバー試験片 による 精度検証：誤差とばらつき	±0.1mm, 1σ=0.03mm	±0.3mm, 1σ=0.1mm
機器動作温度	-10℃ ~ +40℃	
環境性能	直射日光OK、IP50（防塵）、水滴保護用シリコンケース付き	
インターフェイス	WiFi 6、USB Type C	
内蔵バッテリー容量	5,000mAh（連続1時間前後動作可能）（外部からの給電も可能）	

※スキャナー本体

サイズ 180mm x 95mm x 26.5mm
重量 535g

※PC用データ処理ソフトウェア StarVision 動作推奨PC仕様

- CPU: Intel Core i7-11800H 以降
- Main memory: 32GB以上
- USB 3.2 Type C port
- Windows 11

お問い合わせ

株式会社セイコーウェーブ
TEL: 042-595-7041
Email: sales@seikowave.jp



※注意：本文書の内容は今後改訂される可能性があります。